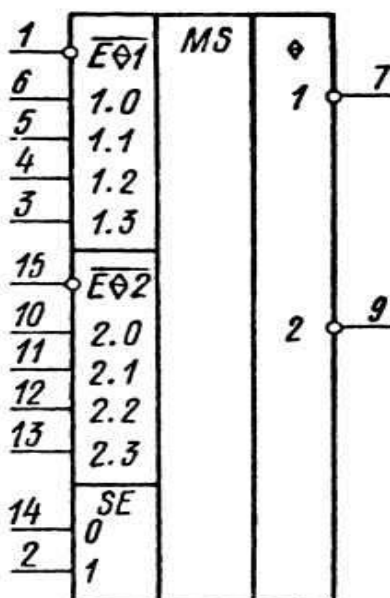


КР1533КП19, КФ1533КП19, ЭКФ1533КП19

Микросхемы представляют собой сдвоенный селектор-мультиплексор 4х1 с инверсией входной информации, общими входами выбора данных и отдельными входами стробирования. Корпус типа 238.16-1, масса не более 1,2 г и 4307.16-А.

Назначение выводов: 1 - вход разрешения $\overline{E}\phi 1$; 2 - вход выбора SE1; 3 - вход информационный D1.3; 4 - вход информационный D1.2; 5 - вход информационный D1.1; 6 - вход информационный D1.0; 7 - выход информационный $\overline{Q}1$; 8 - общий; 9 - выход информационный $\overline{Q}2$; 10 - вход информационный D2.0; 11 - вход информационный D2.1; 12 - вход информационный D2.2; 13 - вход информационный D2.3; 14 - вход выбора SE0; 15 - вход разрешения $\overline{E}\phi 2$; 16 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533КП19, КФ1533КП19, ЭКФ1533КП19

Таблица истинности

Вход						Выход	
SE1	SE0	0	1	2	3	\overline{E}	\overline{Q}
X	X	X	X	X	X	1	1
0	0	0	X	X	X	0	1
0	0	1	X	X	X	0	0
0	1	X	0	X	X	0	1
0	1	X	1	X	X	0	0
1	0	X	X	0	X	0	1
1	0	X	X	1	X	0	0
1	1	X	X	X	0	0	1
1	1	X	X	X	1	0	0

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня	≤ 0,4 В
Выходное напряжение высокого уровня	≥ 2,4 В
Прямое падение напряжения на антизвонном диоде	≤ -1,5 В
Ток потребления при $U_n = 5,5$ В	≤ 10 мА
Входной ток низкого уровня	≤ -0,1 мА
Входной ток высокого уровня	≤ 20 мкА
Входной пробивной ток	≤ 0,1 мА
Выходной ток	-30 ... -112 мА
Время задержки распространения сигнала при включении:	
- от выводов 14, 2 к выводам 7, 9	≤ 21 нс
- от выводов 6, 5, 3, 4 к выводу 7, от выводов 10, 11, 12, 13 к выводу 9	≤ 13 нс
- от выводов 1, 15 к выводам 7, 9	≤ 20 нс
Время задержки распространения сигнала при выключении:	
- от выводов 14, 2 к выходам 7, 9	≤ 24 нс
- от выводов 6, 5, 3, 4 к выходу 7, от выводов 10, 11, 12, 13 к выходу 9, от выводов 1, 15 к выходам 7, 9	≤ 18 нс

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня	2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход	5,5 В
Температура окружающей среды	-10...+70 °С

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя

погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В \pm 10%, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.